TAZMO

タツモ株式会社
決算説明資料

2026年12月期 第3四半期

2026年11月13日

証券コード 6266

会社案内ダウンロード

https://tazmo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/company%20guide.pdf

INDEX
目次

1. 2026年12月期 第３四半期 連結業績
2. セグメント別業績
3. 市場（顧客）の状況
4. 補足資料

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.



1

2026年12月期第3四半期　連結業績

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

2026年12月期第3四半期　決算ハイライト

TAZMO

売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する四半期純利益
21,127百万円	1,383百万円	1,391百万円	774百万円
前年同期比 △22.1%	前年同期比 △68.7%	前年同期比 △68.8%	前年同期比 △75.6%

■ 概況

- 当四半期は、半導体装置セグメントと表面処理用機器セグメントで検収遅れが発生した。これに加え、上半期に発生した未検収装置の評価減と原価増加分の引き当てが利益を押し下げ、Q3累計は前年同期比で減収減益、期初計画も下回る結果となった。
- 受注は、半導体装置セグメントのコーター/デベロッパーがQ2に続いて高水準。加えて搬送装置セグメントや、表面処理用機器セグメントが受注をけん引し、受注残高は68,054百万円（前年同期末比3.1倍）に増加した。

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

2026年12月期第3四半期　連結業績

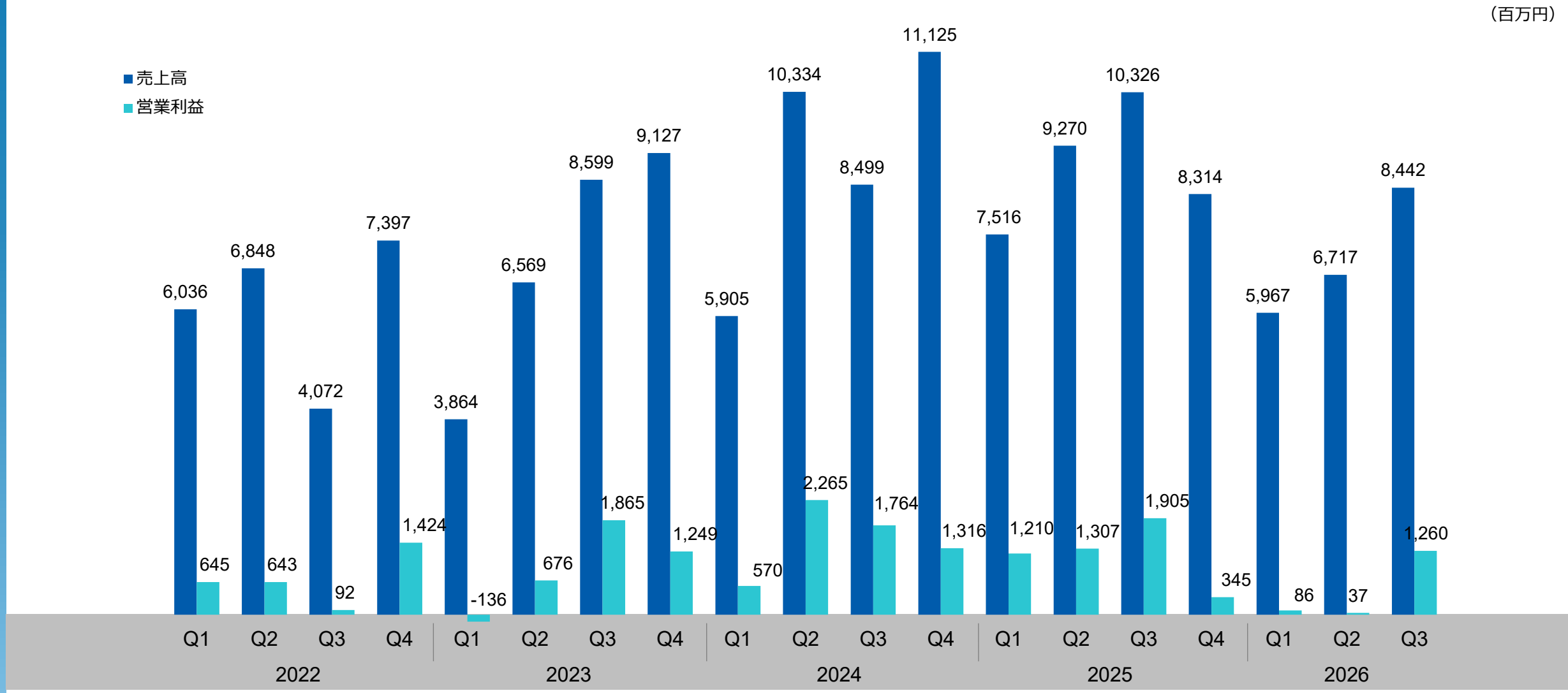
TAZMO

（百万円）	2025年12月期 Q3累計実績	2026年12月期 Q3 実績	2026年12月期 Q3 売上比(%)	前年同期比増減率(%)	2026年12月期 計画	進捗率(%)
売上高	27,114	21,127	–	△22.1	35,500	59.5
売上総利益	8,512	6,624	31.4	△22.2	–	–
営業利益	4,423	1,383	6.6	△68.7	3,600	38.4
経常利益	4,454	1,391	6.6	△68.8	3,500	39.7
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,175	774	3.7	△75.6	2,500	31.0

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

連結売上高・連結営業利益推移（四半期）

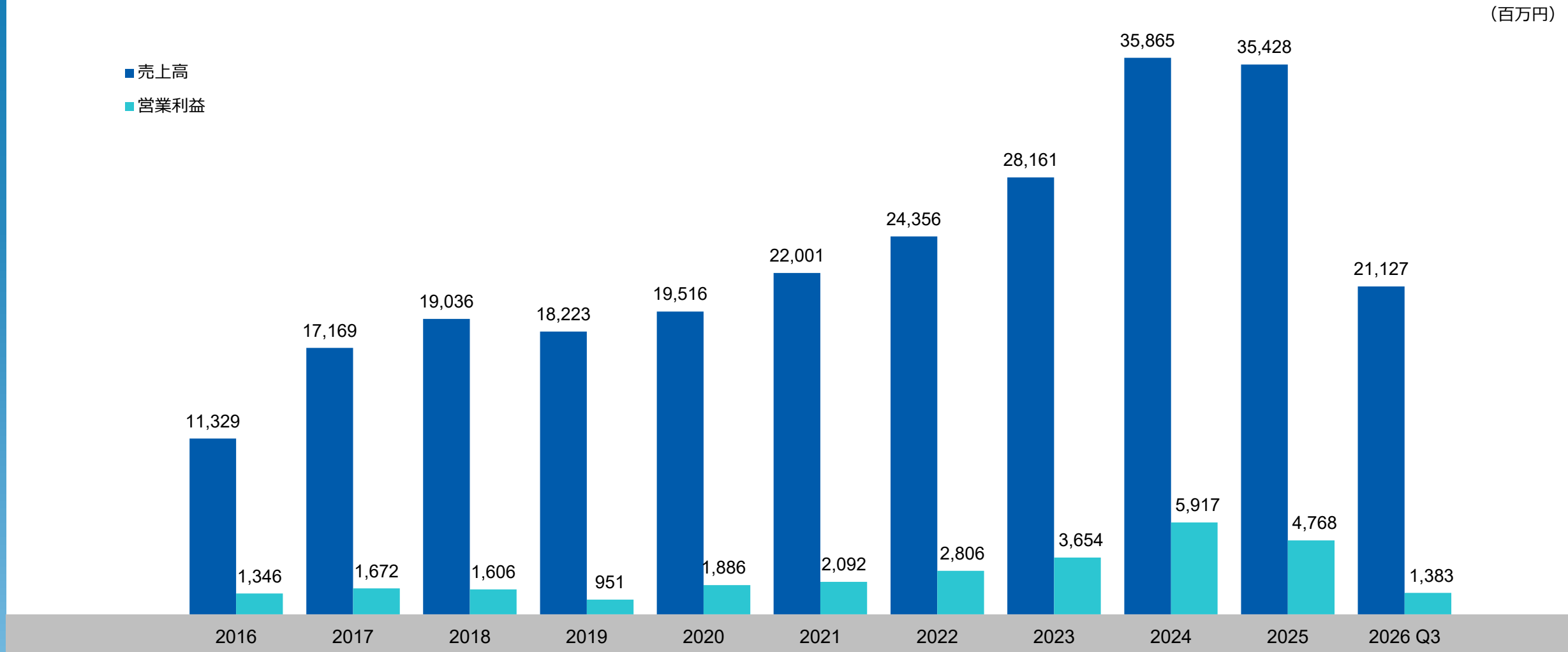
TAZMO



© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

連結売上高・連結営業利益推移（通期）

TAZMO



© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

連結貸借対照表

TAZMO

（百万円）	2025年12月期	2026年12月期 Q3	前期比増減
流動資産	37,809	39,707	1,897
固定資産	9,083	12,125	3,041
有形固定資産	7,812	10,831	3,018
無形固定資産	199	189	△9
投資その他資産	1,070	1,103	32
総資産合計	**46,893**	**51,832**	**4,939**
流動負債	14,393	19,338	4,944
固定負債	5,462	5,008	△454
負債合計	**19,855**	**24,346**	**4,490**
純資産合計	**27,037**	**27,485**	**448**
自己資本比率	56.6%	52.0%	△4.6P

主な増減要因

流動資産

（百万円）

現金及び預金	△6,234
受取手形及び売掛金	+541
電子記録債権	△495
棚卸資産	+6,357

流動負債

支払手形及び買掛金	+2,251
電子記録債務	△1,209
未払法人税等	△738
契約負債	+4,664

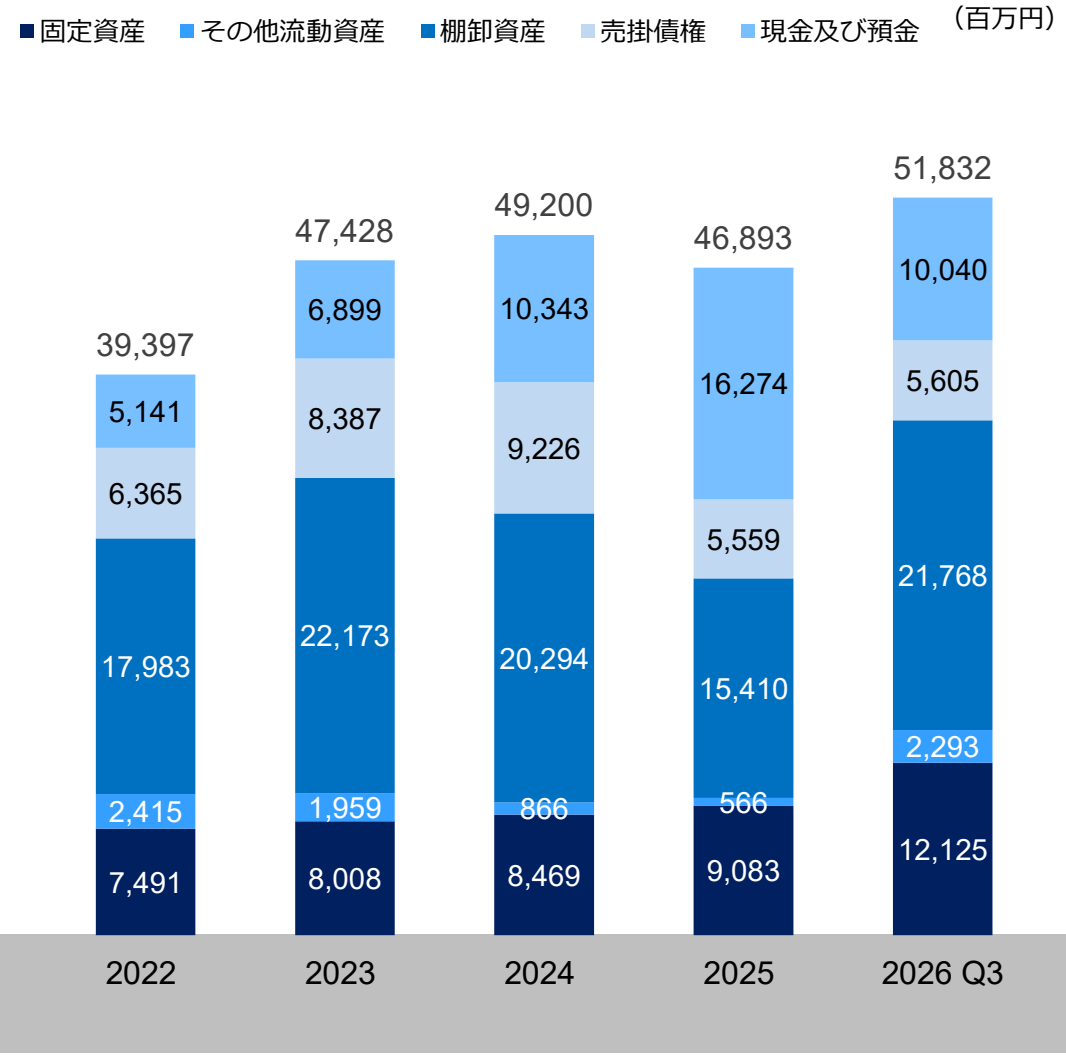
固定負債

長期借入金	△513

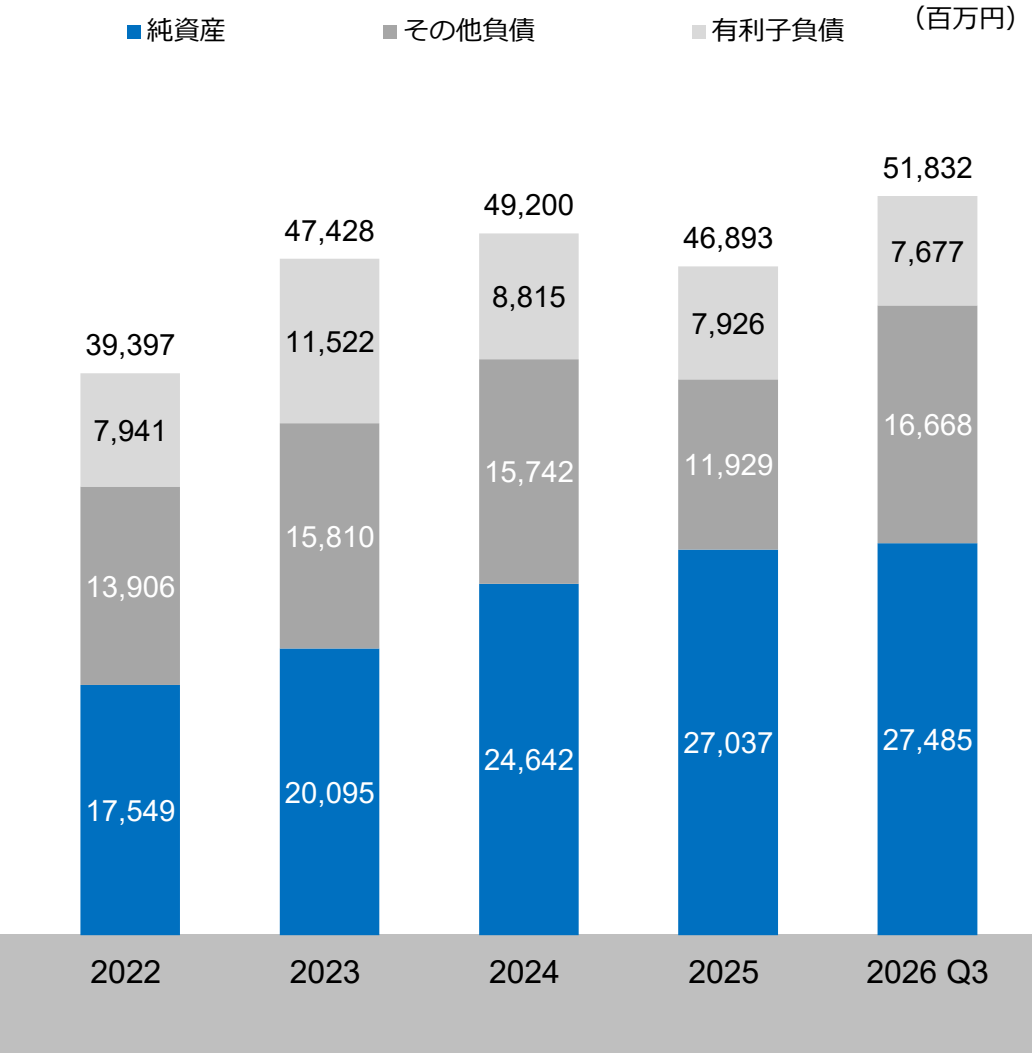
© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

資産・負債／純資産推移

資産



負債／純資産



© 2024 TAZMO Co.,Ltd.



2 セグメント別業績

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

2026年12月期第3四半期　セグメント別業績

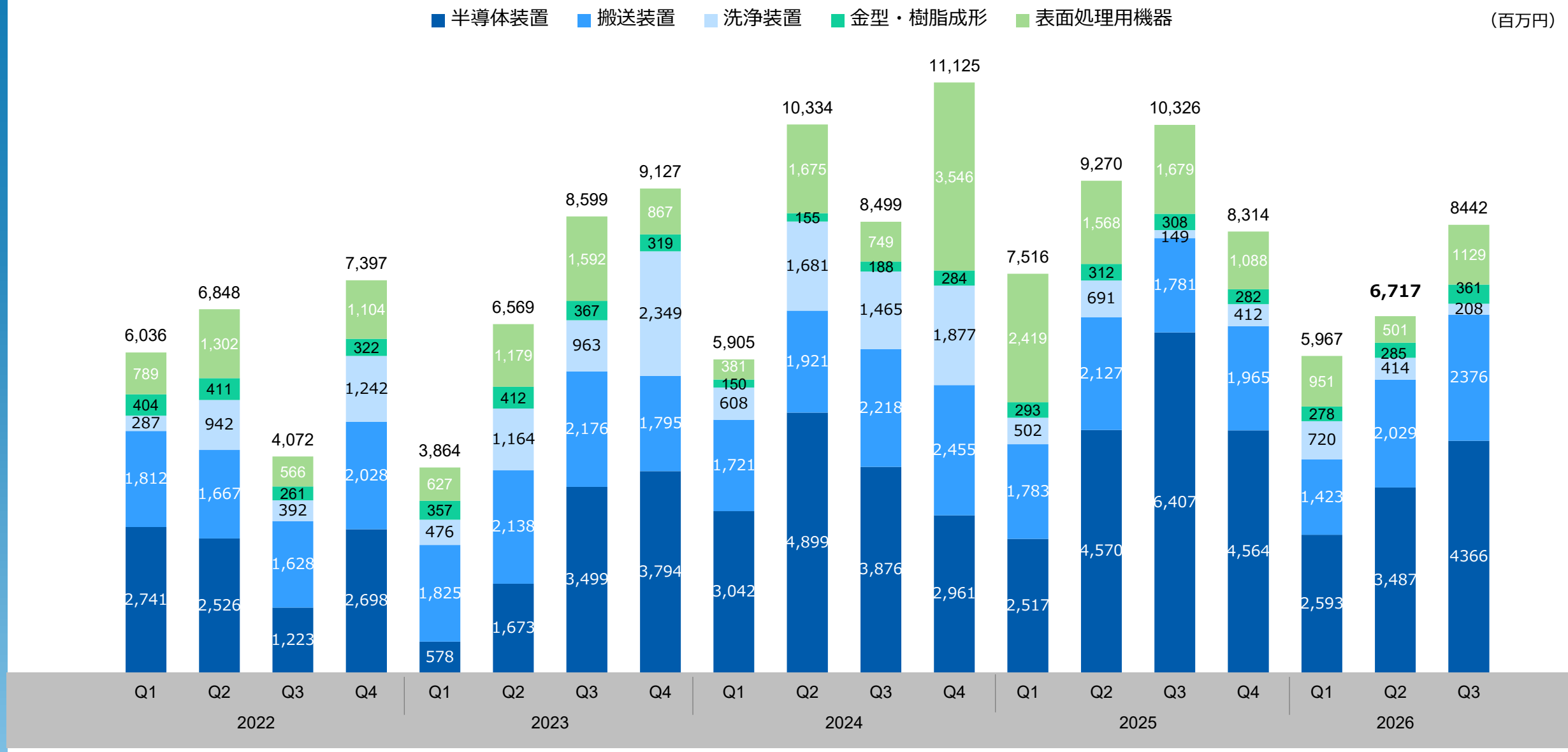
TAZMO

	（百万円）	2025年12月期 Q3累計実績	2026年12月期 Q3累計実績	前期比 増減率(%)	2026年12月期 計画	進捗率(%)
プロセス機器事業	売上高	20,533	17,619	△14.2	29,700	59.3
	営業利益	3,566	1,509	△57.7	3,400	44.4
■ 半導体装置	売上高	13,496	10,446	△22.6	18,500	56.5
■ 搬送装置	売上高	5,692	5,828	2.4	8,860	65.8
■ 洗浄装置	売上高	1,343	1,344	0.0	2,340	57.4
金型・樹脂成形事業	売上高	915	925	1.2	1,300	71.2
	営業利益	95	15	△84.1	70	21.4
表面処理用機器事業	売上高	5,666	2,581	△54.4	4,500	57.4
	営業利益	733	△90	–	130	–
セグメント間連結調整	営業利益	28	△50	–	—	—
合計	売上高	27,114	21,127	△22.1	35,500	59.5
	営業利益	4,423	1,383	△68.7	3,600	38.4

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

セグメント別　売上高推移（四半期）

TAZMO

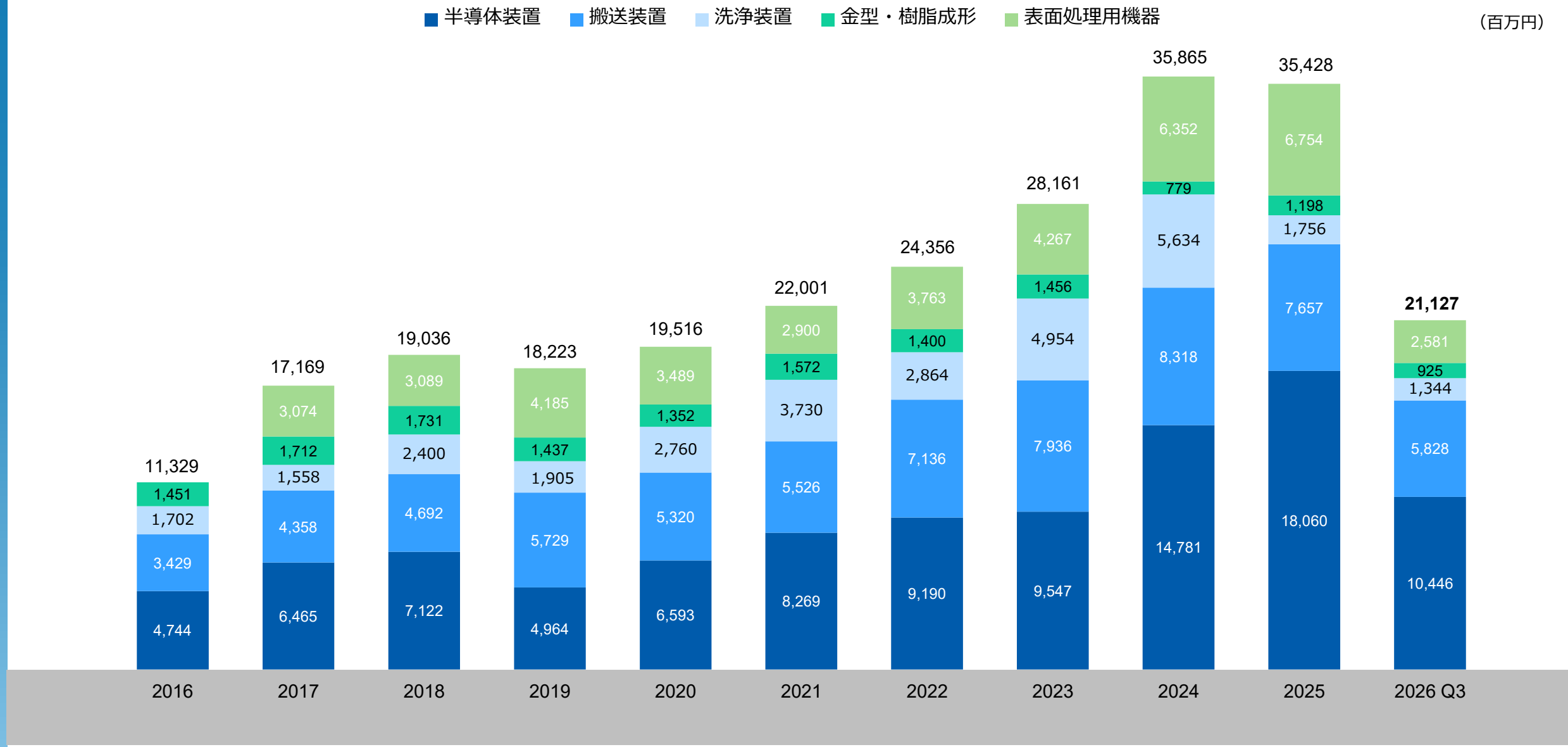


※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、
過去実績についても同様のセグメント区分で記載。従来表記の売上高推移は補足資料参照。

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

セグメント別　売上高推移（通期）

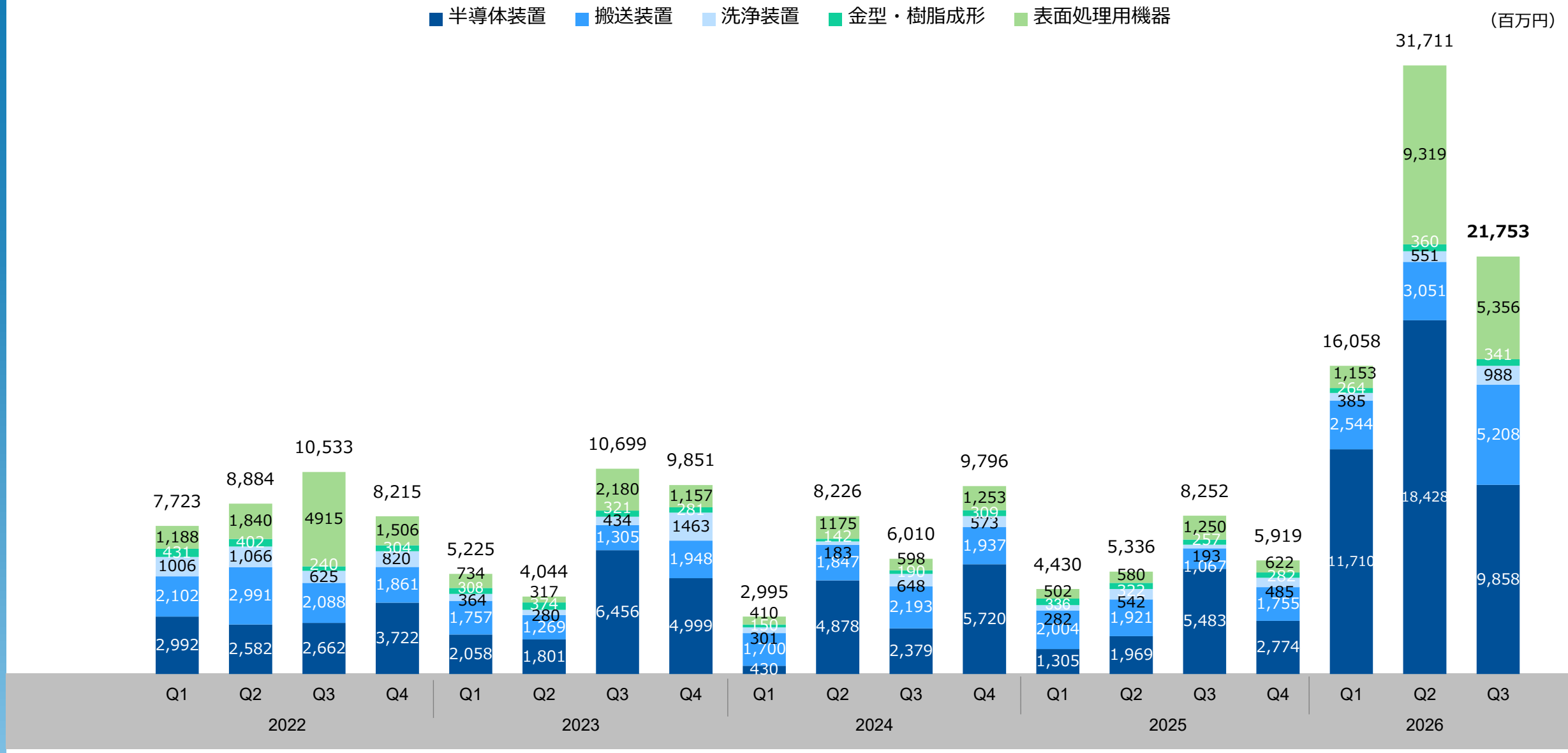
TAZMO



※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、
過去実績についても同様のセグメント区分で記載。従来表記の売上高推移は補足資料参照。

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

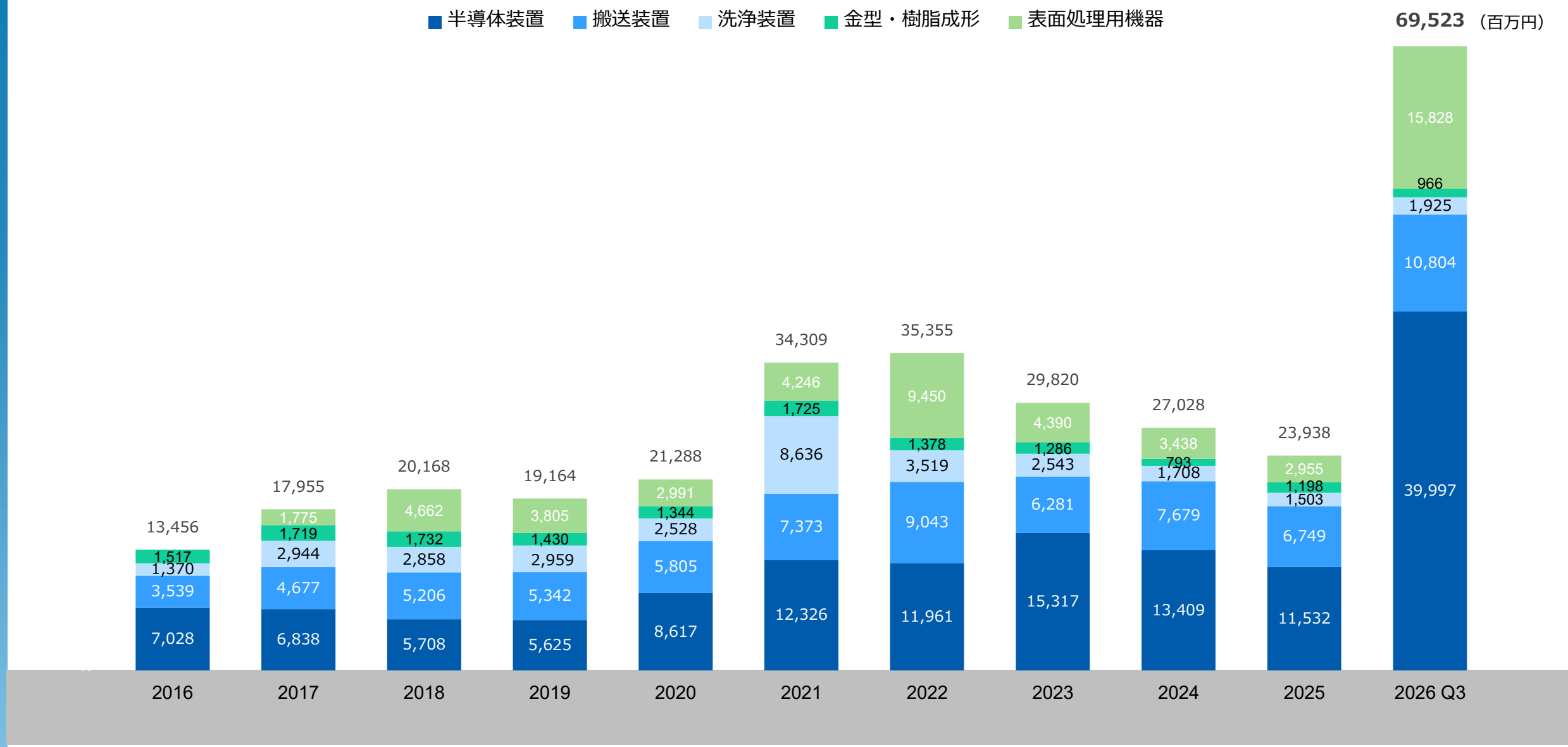
セグメント別　受注高推移（四半期）



※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、
過去実績についても同様のセグメント区分で記載。従来表記の受注高推移は補足資料参照。

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

セグメント別　受注高推移（通期）

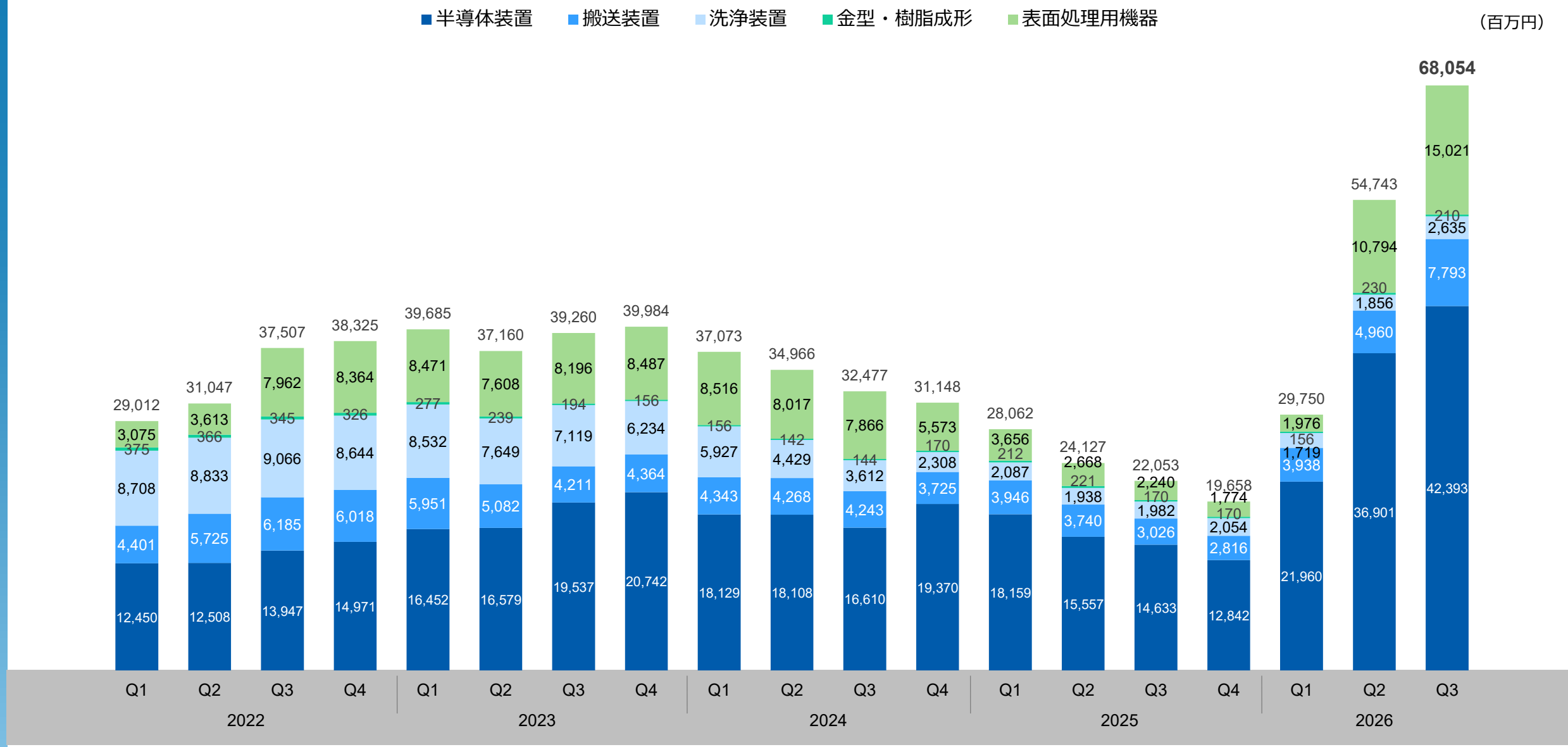


※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、
過去実績についても同様のセグメント区分で記載。従来表記の受注高推移は補足資料参照。

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

セグメント別　受注残高推移

TAZMO



※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、
過去実績についても同様のセグメント区分で記載。従来表記の受注残高推移は補足資料参照。

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.



3 市場（顧客）の状況

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

市場（顧客）の状況

TAZMO

- 半導体装置では、先端パッケージ向けの旺盛な装置需要を背景に、コーター/デベロッパー（厚膜塗布・現像装置）の受注が2Qに続き高水準で推移。TB/DB（貼合・剥離）装置は、上期に先端パッケージ向けの大型受注があった影響で、相対的な受注額は小さい。一方で引き合いは継続しており、今後の受注に期待している。パワー半導体向けTB/DBの引き合いも強まっている。

- 搬送装置では、引き合いが増加しており、受注額もQoQで大幅に増加した。部材の長納期化や個別要求への対応などの課題はあるが、国内外のサプライチェーンを強化し、確実な納入に取り組んでいる。

- 表面処理用機器では、基板搬送装置を中心に例年水準を大きく上回る受注が継続し、受注残高も高水準に積み上がっている。今後のパッケージ基板需要の増加に期待している。

- PLP向け装置では、塗布、剥離・洗浄など、これまで取り組んできたプロセスへの引き合いに対し、確実に受注できるよう対応を進めている。

- スラリー供給装置の引き合いは増加しており、今後のさらなる受注に期待している。
ウェーハ洗浄装置は新規案件の話も少なく、回復には時間がかかると見ている。

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

4

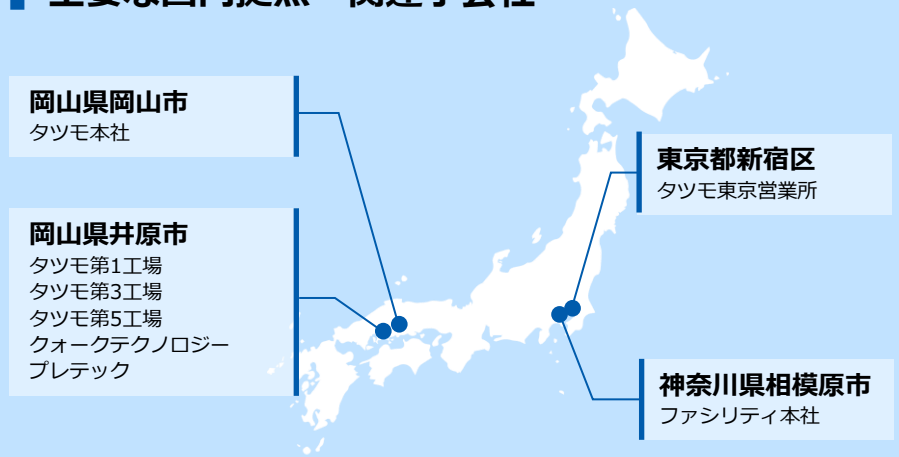
補足資料

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

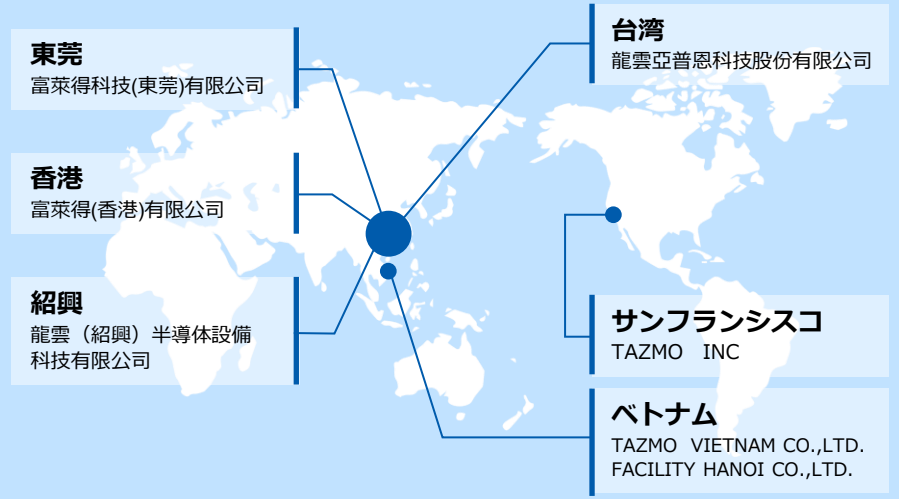
会社概要

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億6,859万682円
発行済株式数	14,842,354株
株主数	6,279 名（2026年6月30日現在）
従業員数	単体 481名／連結 1,224名（2026年6月30日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 紫外線照射装置、めっき処理装置、 精密金型・樹脂成形品などの開発・製造・販売

主要な国内拠点・関連子会社



主要な海外拠点



© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

会社概要と業況

TAZMO

売上の8割近くを半導体関連（プロセス機器事業）が占めます。海外売上比率は約52%で、グローバルに展開する半導体装置メーカーです。

【2026年現在　会社概要】

グループ従業員数
連結・2026年6月30日現在
1,224名

創業
1972年
55年目

拠点数
国内11＋海外12
23拠点

関連子会社数
国内・海外合計
14社

【2025年12月期　通期実績】

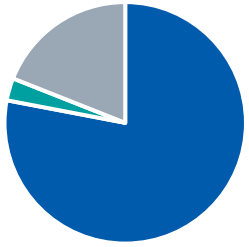
売上高
2025年12月期
354.2億円

営業利益
2025年12月期
47.6億円

営業利益率
2025年12月期
13.5%

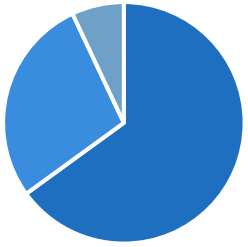
ROE
2025年12月期
14.0%

セグメント別　売上構成比
2025年12月期



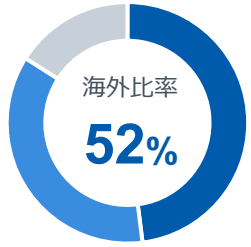
プロセス機器（半導体関連）	78%
金型・樹脂	3%
表面処理	19%

プロセス機器　売上構成比
2025年12月期



半導体装置	65%
搬送装置	28%
洗浄装置	7%

地域別売上構成比
2025年12月期



日本	48%
台湾	36%
その他	16%

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

事業の変遷と装置出荷台数の推移

TAZMO

1980年代に半導体装置へ参入。以降はFPD、パワー半導体、先端パッケージと時代のニーズに柔軟に対応。現在は販売の中心をOEMから直販へ転換、半導体製造のプロセス開発から関わっています。

①創業～1990年代

半導体装置事業に参入。OEMを中心としてウェットプロセスと搬送の技術を蓄積。

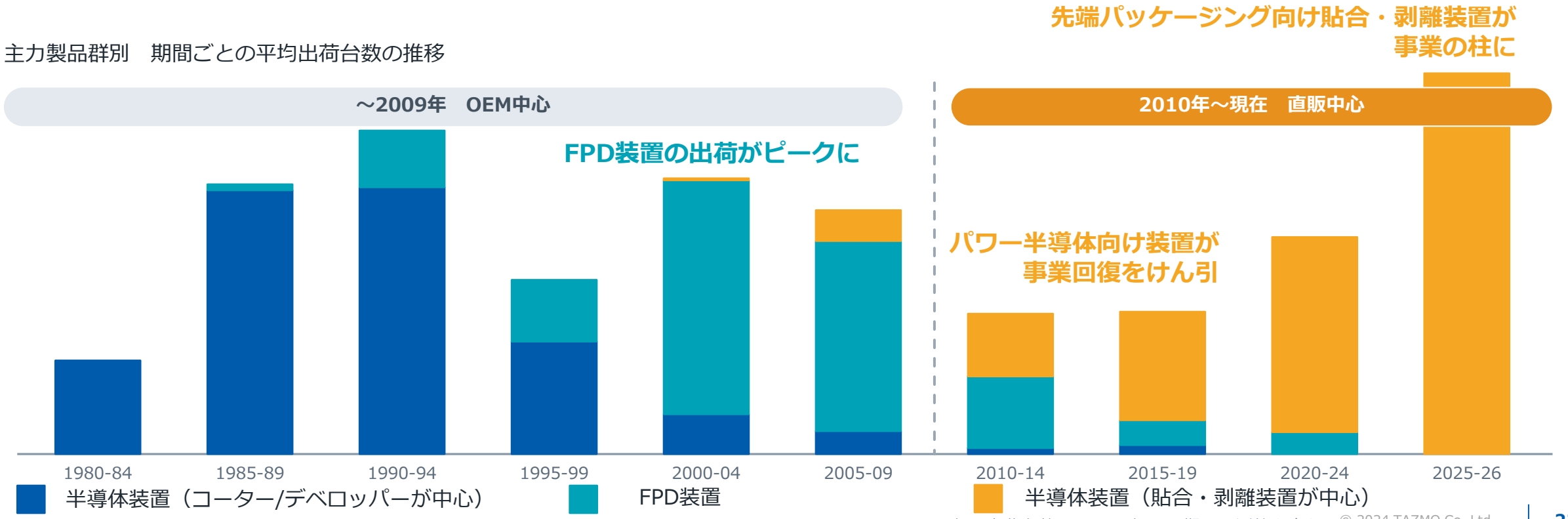
②2000年代

FPD装置(OEM)が事業の柱に。2000年代中盤が出荷台数のピーク。

③2010年代～現在

FPDから半導体装置へ。パワー半導体、先端パッケージへ広がり、販売もOEM中心から直販中心へ転換。

■主力製品群別　期間ごとの平均出荷台数の推移



※2025-26年の出荷台数には2026年12月期の予測値を含む。

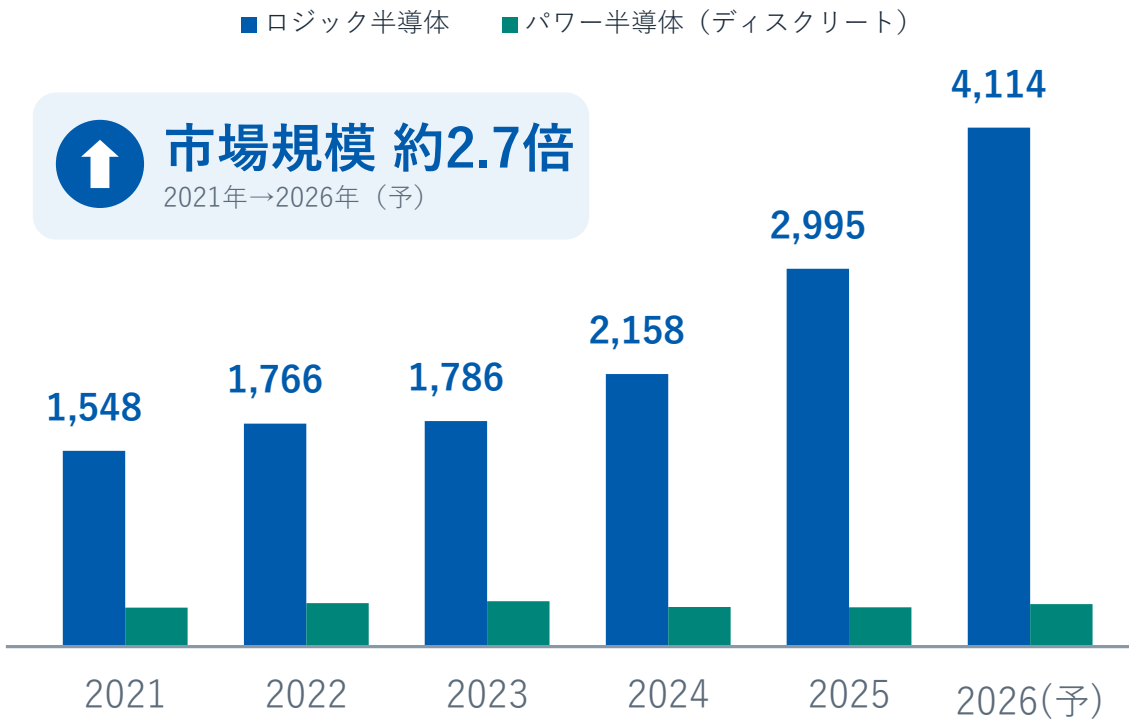
© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

ロジック半導体市場の拡大とともに成長

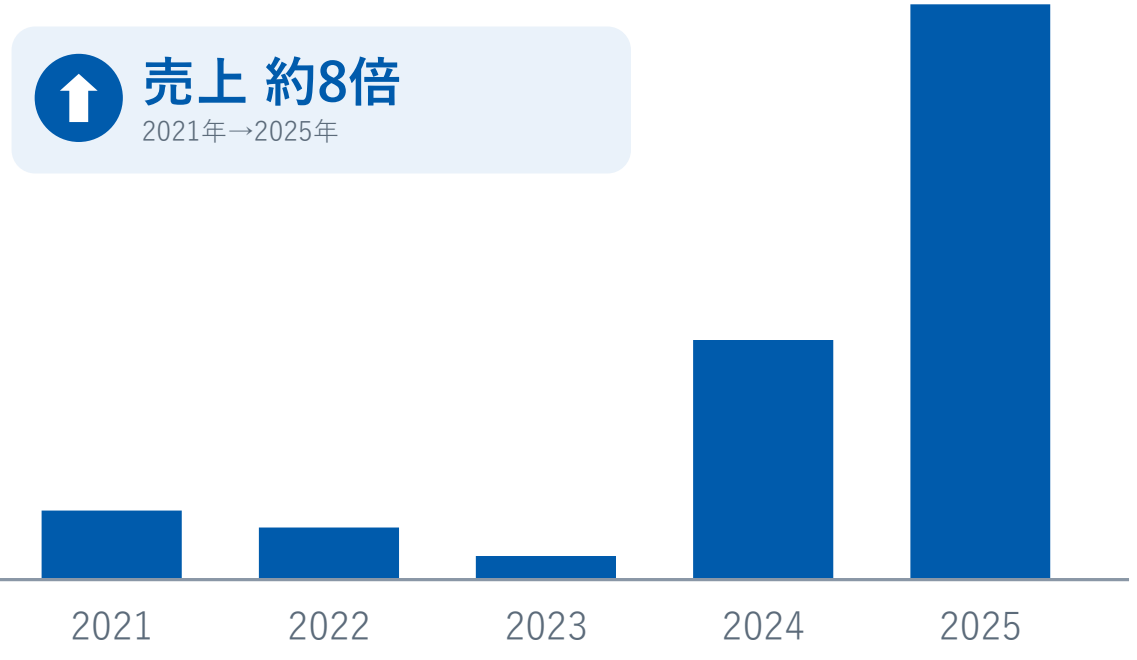
TAZMO

AI向けロジック半導体の市場規模拡大により、タツモの先端パッケージ向け貼合剥離装置の売上が大幅に拡大。要求される技術水準が高まるロジック半導体製造にタツモの装置は使われています。

■ロジック半導体とパワー半導体の市場規模比較



■タツモ先端パッケージ向け装置　売上推移

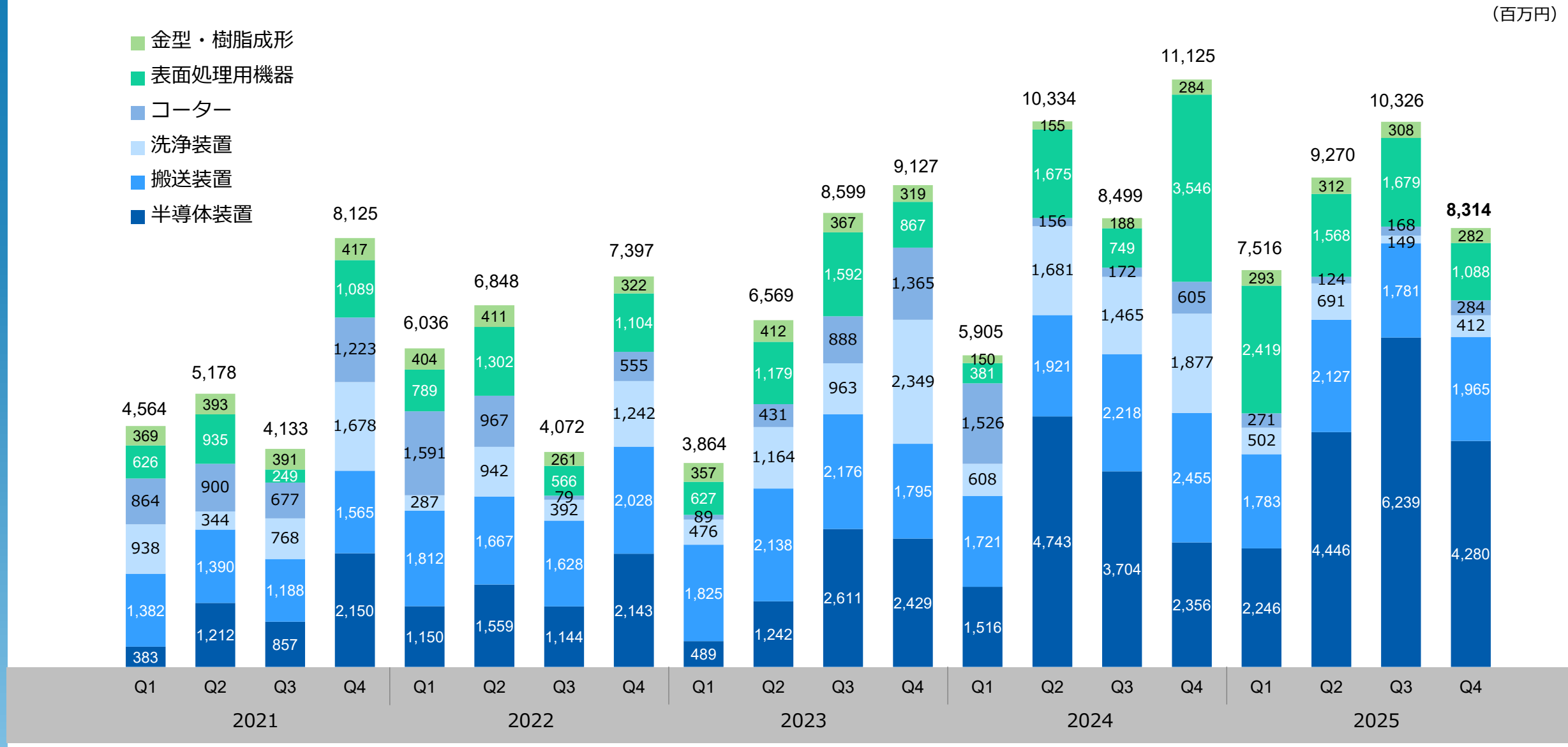


出典：WSTS（2021～2025年は実績、2026年は2026年春季予測 2026年6月）。
※ディスクリートはパワー半導体を中心とする区分。
※単位：億ドル

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

従来セグメント別　売上高推移（四半期）（～2025年）

TAZMO

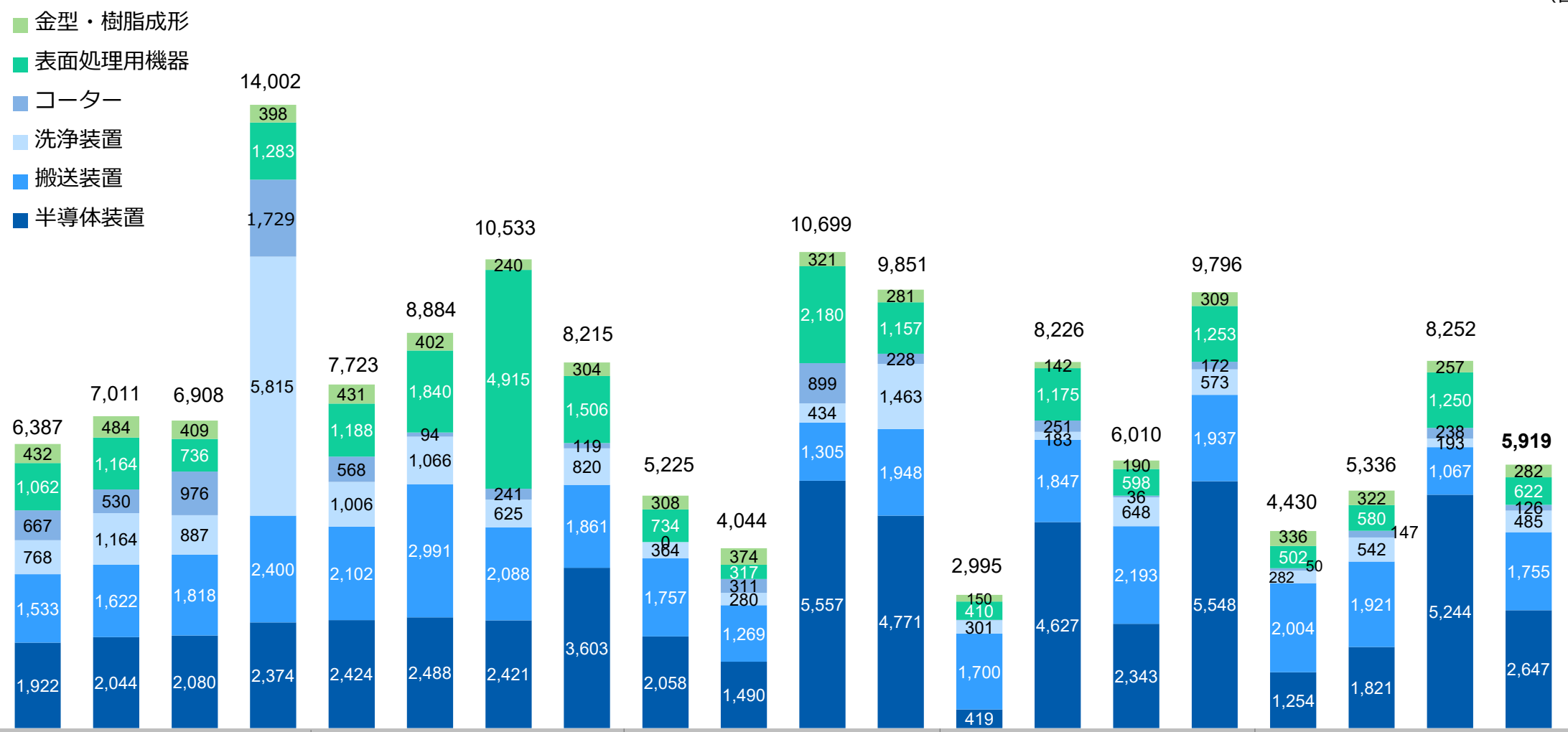


© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

従来セグメント別　受注高推移（四半期）（～2025年）

TAZMO

（百万円）

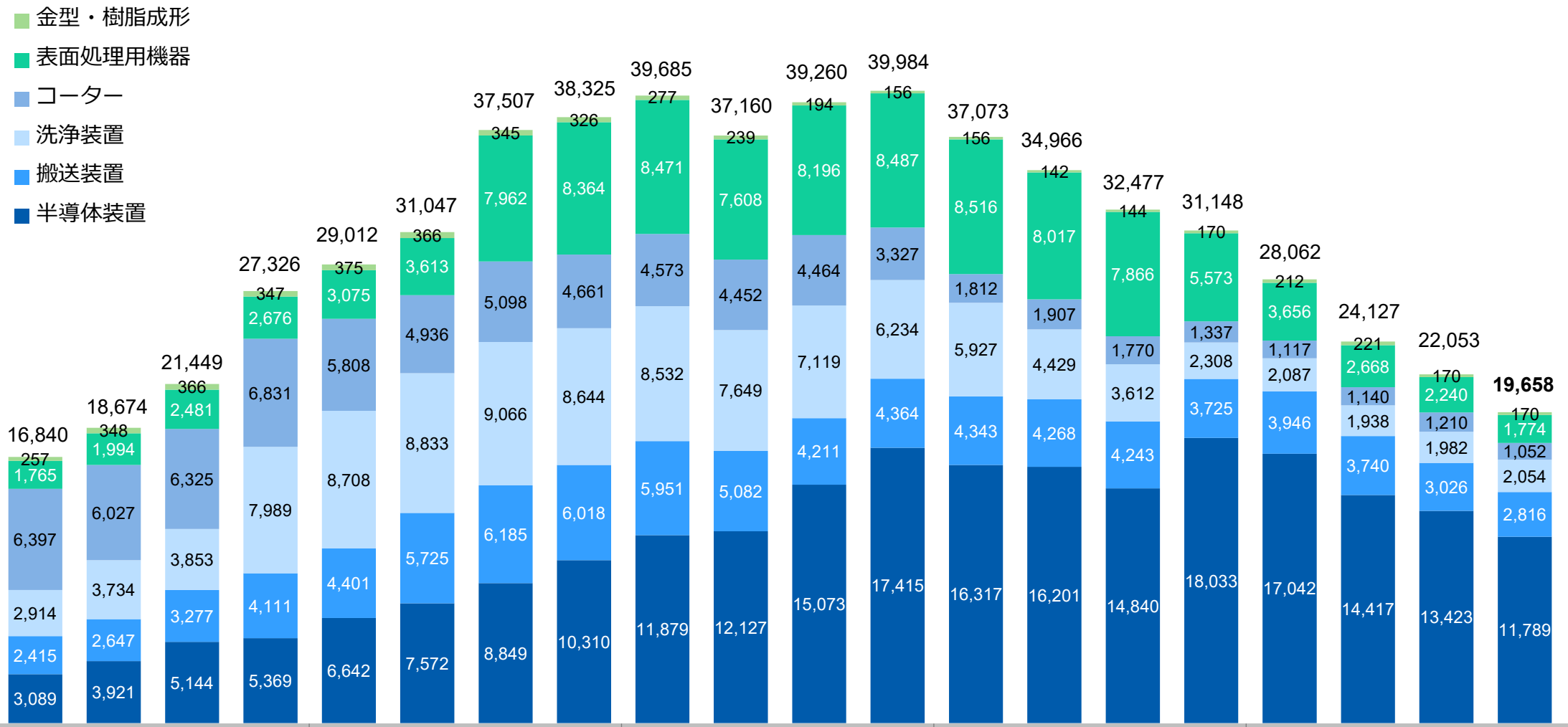


© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

従来セグメント別　受注残高推移（～2025年）

TAZMO

（百万円）



© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

沿革

TAZMO

1972
- 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立

1980
- インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始

1989
- 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始

1990
- 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始

1994
- エンボスキャリアテープの製造・販売を開始

1995
- インジェクション成形品の製造・販売を開始

2001
- 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、
- 製造・販売を開始

2004
- JASDAQ市場に株式を上場

2008
- TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立

2009
- 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結

2013
- アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築

2017
- 株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化

2018
- 東京証券取引所市場第一部へ市場変更

2019
- 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転

2020
- アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併

2022
- 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資
- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

事業概要

半導体装置事業

貼合・剥離装置

- 先端パッケージ向け装置（WLP ※1／PLP ※2）
- パワー半導体向け装置



高性能チップの製造に欠かせないウェーハの薄化を実現する仮接合・剥離装置の開発・設計・製造・販売を行っています。
ウェーハにガラス支持体を貼り合わせることで、ウェーハの損傷を防ぎながら薄化が可能です。

厚膜塗布・現像装置

FPD製造装置の開発・製造で培った知見をもとに、均一な薬液の塗布の実現と、現像装置で露光された部分のみを洗い流すことで精密な回路作りを可能にしています。

※1 WLP：ウェーハレベルパッケージ
※2 PLP ：パネルレベルパッケージ

搬送装置事業

- 半導体装置メーカー向け（ウェーハ、マスクなどに対応）



半導体製造装置内で使用される搬送ロボットや、ユニットをフレームに組み込んだEFEMなどの開発・設計・製造・販売を行っています。

洗浄装置事業

ウェーハメーカー向けの枚葉洗浄装置のほか、スラリー供給装置、廃液からリン酸を再生・再利用する装置の開発・設計・製造・販売を行っています。

金型・樹脂成形事業

コネクタメーカー向けに精密金型や樹脂成形品を提供しています。

表面処理用機器事業

半導体のパッケージや、自動車等の電子制御システムに組み込まれている、プリント回路基板に対するめっき処理装置の提供を行っています。

© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

本資料の取扱上の注意

本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

また、本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、当社の発行する有価証券売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社　経理部IR課

086-239-5000

086-239-5100

keiki@tazmo.co.jp